

[KAIST IDEC] 시스템반도체설계 실무인력양성사업 컨소시엄 기업 모집

■ 사업 개요

- 사업목표 : 시스템반도체 분야 산업경쟁력 강화를 위한 사업계 수요 기반의 교육 과정 개발 및 교육센터 운영을 통한 실무인력 양성
- 총 사업기간 : 2022.04.01~2028.12.31(6년 9개월)
- **2차년도 사업기간 : 2023.01.01~2023.12.31(12개월)**
- 주관수행기관 : KAIST 반도체설계교육센터(IDEC)
- 성과지표

성과지표		목 표							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	계
교육 수료	장기(미취업자)	20	180	180	180	180	180	180	1,100
인원 (명)	단기(재직자)	240	900	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	6,640

■ 컨소시엄 기업 협약

- 협약 기간 : 2023.09.01~2024.08.31 (1년)
- 컨소시엄 기업 혜택 및 의무 사항

구분	내용
혜택사항	1. 수강생 우선 채용 기회 부여 2. 교육 커리큘럼 기획시 참여 3. 교육과정 중 회사 소개 기회 부여 4. 채용 연계 프로그램(Job Fair) 참여 5. 기업 추천 인재 우선 선발 (해당 기업 재직자에 한함) 6. 수강생 선발시 심사위원으로 참여
의무사항	1. 연회비 : 기업당 300만원/년 2. 학생 채용시, 차년도 연회비에 학생당 100만원씩 추가하여 납부 (6개월 이상 재직시 해당)

- 사업 소개 및 2022년 컨소시엄 기업 참여 현황
=> <https://academy.idec.or.kr/project/>

■ 장기(4개월) 교육 운영

- 교육대상 : 반도체 분야 취업을 희망하는 전공, 비전공의 학부 졸업(예정자), 컨소시엄 기업 추천자 등
 - 교육참가비 : 무료 (교육지원금, 중식, 교재 무료 제공)
 - 협약 기간 내 교육기간 및 교육 내용
 - 제4기 : 2023.09~2023.12(4개월) / 아날로그 트랙(RF IC 특화), 인공지능(AI) 트랙
 - 제5기 : 2024.01~2024.04(4개월) / 아날로그 트랙, 디지털 트랙
 - 제6기 : 2024.05~2024.08(4개월) / 아날로그 트랙, 디지털 트랙
 - 제7기 : 2024.09~2024.12(4개월) / 아날로그 트랙, 디지털 트랙
- *2024년 교육 세부 주제는 추후 결정 예정*
- 교육 과정

구분	총 16주 과정				
	O/T	기초+심화 과정 (교수, 업체 강사진)		실습과정 (IDEC 연구원)	취업 연계
아날로그	1일	기초과목(6주)	심화과목(6주)	응용실습(4주)	2일
디지털		기초과목(8주)	심화과목(4주)		

■ 제4기 수강생 모집

- 신청기간 : 2023.06.19~07.11 (3주간)
- 모집정원 : 80명
- 신청인원 : 228명 (약 3:1 경쟁률)
- 선발전형 : 서류 및 면접평가를 통해 최종 선발
- (참고 1) 제4기 홍보 포스터



■ 컨소시엄 기업 신청 방법

- 신청기간 : **2023.08.07(월)~2023.08.25(금)**
- 신청방법 : 아래 담당자에게 참여 희망 메일 발송
김영지 선임, 031-8036-2466, yeongji@kaist.ac.kr

- (참고 2) 제4기 최종 합격자 80명 명단(대외비)

제 4 기 아날로그 트랙(RF IC 특화) 교육생 리스트

No.	이름	생년	소속	학과
1	권**	1998	가천대학교	전자공학과
2	김**	1997	서울과학기술대학교	전자 IT 미디어공학과
3	김**	1999	전남대학교	전자공학과
4	김**	2000	단국대학교	디스플레이공학과
5	김**	1997	고려대학교	전기전자공학부
6	김**	2001	아주대학교	전자공학과
7	나**	1999	경희대학교	정보디스플레이학과
8	노**	1998	단국대학교	전자전기공학부
9	도**	1997	고려대학교	신소재공학부
10	문**	1998	부산 대학교	전기공학과
11	박**	1998	송실대학교	전자정보공학부
12	박**	1996	인하대학교	전기공학과
13	송**	1997	광운대학교	전자공학과
14	신**	1999	이화여자대학교	전자전기공학전공
15	오**	1999	인하대학교	전자공학과
16	오**	2000	세종대학교	전자정보통신공학과
17	오**	1999	아주대학교	전자공학과
18	이**	1998	송실대학교	전자정보공학부
19	이**	1998	단국대학교	전자전기공학부
20	이**	1997	세종대학교	전자정보통신공학과
21	이**	1995	단국대학교	전자전기공학부
22	이**	1998	서울시립대학교	전자전기컴퓨터공학부
23	이**	2001	한성대학교	전자정보시스템
24	이**	1996	홍익대학교	전자전기공학부
25	이**	1999	한국항공대학교	전자및항공전자공학전공
26	장**	1999	단국대학교	전자전기공학부
27	장**	1997	전북대학교	전자공학부
28	전**	2000	경희대학교	생체의공학과/ 전자공학과
29	전**	1999	강원대학교	전자공학과
30	정**	2000	대림대학교	스마트전자통신학부
31	정**	2000	한양대학교(ERICA)	전자공학부
32	조**	2000	한성대학교	전자공학과
33	조**	1999	중앙대학교	전자전기공학과
34	조**	2000	한양대학교(ERICA)	전자공학부
35	조**	1995	가천대학교	전기공학과
36	최**	1999	광운대학교	전자공학
37	최**	1993	인천대학교	전자공학
38	한**	1999	이화여자대학교	전자전기공학부
39	홍**	2001	경기대학교	전자공학과
40	황**	2001	인하대학교	전자공학과

제 4 기 인공지능(AI) 트랙 교육생 리스트

No.	이름	생년	소속	학과
1	강**	1998	순천대학교	전자공학과
2	김**	2000	서울시립대학교	전자전기컴퓨터공학부
3	김**	2000	이화여자대학교	전자전기공학과
4	정**	1999	동국대학교	전자전기공학부
5	박**	1996	한국공학대학교	IT 반도체융합공
6	강**	1998	한경국립대학교	전기전자공학부 전자트랙
7	김**	2001	경기대학교	전자공학과
8	염**	2000	성균관대학교	전자전기공학부
9	박**	1998	단국대학교	전자전기공학부
10	박**	1998	동국대학교	반도체학과
11	이**	1996	세종대학교	전자정보통신공학과
12	황**	1997	한국항공대학교	전자및항공전자공학
13	김**	1998	한국기술교육대학교	메카트로닉스공학부
14	김**	1998	경희대학교	전자공학과
15	김**	1998	세종대학교	전자정보통신공학과
16	이**	1997	아주대학교	전자공학
17	김**	1998	성균관대학교	전자전기공학부
18	표**	1998	건국대학교	화학공학부
19	이**	2000	가톨릭대학교	정보통신전자공학부
20	김**	1999	원광대학교	반도체 디스플레이학부
21	박**	1998	동국대학교	물리반도체과학부
22	유**	2000	동국대학교	융합에너지신소재공학과
23	이**	1995	한국외국어대학교	전자공학과
24	전**	1997	한국해양대학교	전기전자공학과
25	신**	1999	가천대학교	전자공학과
26	김**	2000	인하대학교	전자공학과
27	서**	1998	남서울대학교	드론공간정보공학과
28	박**	1999	수원대학교	전자공학
29	김**	1998	광운대학교	전자공학과
30	송**	1999	명지대학교	화학공학과
31	김**	1997	중앙대학교	전자전기
32	김**	1998	한경대학교	전기전자제어과
33	정**	1996	한양대학교(ERICA)	전자공학부
34	송**	1997	홍익대학교	전자전기공학부
35	조**	1999	충북대학교	전자공학부
36	김**	2001	국민대학교	신소재공학부 전자화학재료전공
37	유**	1995	단국대학교	러시아어, 심리학
38	김**	1996	서울과학기술대학교	전자공학과
39	유**	1999	한국외국어대학교	아프리카학/경제학
40	장**	1993	건국대학교	기술경영학과

- (참고 3) 기존 협약서

시스템반도체 설계실무인력양성 협약서

반도체설계교육센터와 (주)픽셀플러스(이하 “양 기관”이라 한다)는 상호 포괄적 협력을 효율적으로 추진하기 위하여 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(목적) 본 협약은 양 기관이 시스템반도체 분야 산업 경쟁력 강화를 위한 산업계 맞춤형 설계 실무인력양성을 목적으로 한다.

제2조(협약사항) 반도체설계교육센터는 시스템반도체 설계실무인력양성 교육 과정을 성실히 수행하고, (주)픽셀플러스는 다음 각 호에 대한 사항을 적극 지원하고 협력한다.

1. 물적 자원 지원
 - 프로그램 지원을 위한 재정적인 지원
 - 프로그램 참여자에 대한 재정적인 지원(장학금 등)
2. 인적자원 지원
 - 임직원의 강사 지원, 학생 선발 시 심사위원 지원 등
3. 채용연계 프로그램 지원
 - 채용, 인턴, 기업 소개 및 채용박람회 참여 등

제3조(협약 이행) 양 기관은 제2조의 협력사항을 이행하기 위하여 인적·물적 자원의 제공 및 자문 등의 방법으로 상호 교류 협력하며 구체적인 시행사항은 상호 협의하에 따로 정할 수 있다.

제4조(협약 기간 및 변경) 본 협약은 협약 체결일로부터 효력을 발생하며, 협약은 1년간 유효하다. 단, 양 기관이 효력 정지를 요청하지 않는 경우, 자동으로 1년 단위로 연장한다.

이 협약의 체결을 증명하기 위하여 각 기관이 기명날인 또는 서명한 후 각 1부씩 보관한다.

2022년 1월 00일

반도체설계교육센터
소 장 박 인 철

(주)픽셀플러스
대표이사 이 서 규